

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-001

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司

### 2024 年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

##### （二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入 592,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 54,905.68 万元左右，同比增长 10.22%左右。

2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 32,196.39 万元左右，同比增长 64.65%左右。

3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 74,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 35,525.21 万元左右，同比增长 92.33%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

2023 年度实现营业收入：537,094.32 万元。

2023 年度实现利润总额：50,302.81 万元。

2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润：49,803.61 万元。

2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：38,474.79 万元。

2023 年度实现每股收益：1.20 元。

### 三、本期业绩变化的主要原因

2024 年，公司对外积极开拓市场，对内持续提升运营效率，同时在近年来持续高强度研发投入下，多个新产品商用后迅速打开市场。多重因素作用下，公司的经营业绩增长与经营质量改善均取得积极成果。2024 年公司第二季度、第三季度营收连创同期历史新高，第四季度受运营商招标节奏影响，S 系列大部分订单将延后到后续季度逐步释放。2024 年，公司实现营收约 59.20 亿元，同比增加约 5.49 亿元（增长约 10.22%）；实现归属于母公司所有者的净利润约 8.20 亿元，同比增加约 3.22 亿元（增长约 64.65%），全年营收和净利润均创历史新高。

2024 年公司因股权激励确认的股份支付费用约 0.72 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响约 0.75 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024 年归属于母公司所有者的净利润约为 8.95 亿元。

2024 年，公司多个产品线的市场表现取得积极进展：（1）S 系列在国内多个运营商招标中均取得最大份额，持续巩固公司在本领域的领先地位。国际市场继续突破多个发达国家或主要经济体的运营商，全球市场份额继续扩大；（2）T 系列全年销量同比提升超过 30%，持续扩大市场占有率，当前产品已完成国际主流 TV 生态的全覆盖，为公司 T 系列产品进一步扩大国际市场份额打下坚实基础；（3）公司继续携手国内外 Top 级智能终端厂商，持续拓展 A 系列在端侧的应用场景；（4）W 系列全年销量首次突破 1,000 万颗，达到近 1,400 万颗。W 系列自 2020 年上市以来，累积销量超过 3,000 万颗。

研发投入方面，2024 年公司发生研发费用约 13.52 亿元，较去年同期增加约 0.69 亿元。公司自 2022 年以来，连续 3 年研发费用超过 10 亿元，近三年累计研发费用约 38.20 亿元。公司的产品研发始终保持“瞄准大市场、确定性机会、集中投入、高质量研发”的原则，使得公司新产品一经上市，便快速形成批量销售。2024 年，公司多个战略性新产品取得良好的市场表现：（1）6nm 芯片 S905X5 系列，利用端侧 AI 能力，本地完成同声翻译，同声字幕等功能，提升消费者在跨语言环境下的用户体验。6nm 芯片商用仅半年以来，不仅原有客户导入顺利，并且取得多个国际 Top 运营商的订单，预计 6nm 芯片有望在 2025 年达成千万颗以上的

销量；（2）8K 芯片 S928X, 不仅在国内运营商的所有招标中, 均囊括全部份额, 并且取得海外 Top 运营商的订单, 将实现百万级以上的规模出货；（3）Wi-Fi 6 2\*2 芯片, 2024 年全年销量超过 150 万颗, 并且取得运营商市场的突破, 但未达到公司年度销售预期, 在总结规模商用经验的基础上, 2025 年 Wi-Fi 6 2\*2 芯片的市场表现有望进一步加速；（4）A311D2 2024 年销量超过 100 万颗, 随着体感运动游戏在 TV 上的应用, 已成功进入北美、欧洲市场, 该新应用场景将在 2025 年再额外提供百万级以上的销量。公司近年来重点投入的这些新产品, 主要面向的均是确定性大品类的潜力市场, 市场需求明确, 在迈过百万级规模商用门槛之后均已形成规模效应, 未来在这些确定性大市场中将会快速形成更大规模的销售。这将为公司在原有优势产品线之外, 提供新的强劲增长动力。与此同时, 公司在研产品亦有积极进展, 近期 Wi-Fi AP 芯片已顺利完成流片, 有助于继续扩展 W 系列产品的应用领域。

公司作为智能家居行业的领导者和新技术的开拓者, 多年来持续携手国内外 Top 客户, 推动智能软硬件技术在智能家居领域的应用, 公司当前已有超过 15 款商用芯片携带公司自研的端侧 AI 算力单元, 2024 年携带自研端侧 AI 算力单元的芯片出货量超过 800 万颗, 覆盖了公司产品的主要应用领域, 通过在大规模终端的商用, 积累了丰富的应用场景和应用经验, 为进一步推动端侧 AI 技术在消费电子领域更广范围、更丰富场景和形态的落地, 提升消费者对电子产品的体验, 奠定了强有力的基础。

公司确定 2024 年为“运营效率提升年”, 在年初制定了一系列运营效率提升行动项, 随着这些行动项的逐步落地, 公司 2024 年的运营效率持续提升, 上半年实现综合毛利率 35.37%, 下半年实现综合毛利率 37.59%。2025 年公司运营效率提升的行动项还将持续落地, 预计运营效率将会继续改善。

随着公司新产品的持续上市与商用放量, 市场机会的不断发掘, 新的业务版图不断扩张, 运营效率的持续提升, 公司的经营还将继续改善, 预计 2025 年第一季度以及 2025 年全年, 公司经营业绩将同比进一步增长。具体业绩存在一定不确定性。

#### 四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年1月21日